

日月光一〇四年度第四季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 105 年 1 月 29 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇四年度第四季獲利報告，本公司一〇四年第四季之合併營業收入較一〇四年第三季成長 4%，較一〇三年同期下滑 1%，為新台幣 75,548 百萬元。茲將日月光一〇四年度第四季單季及全年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第四季	104 年度 第三季	103 年度 第四季	104 年度 全年度	103 年度 全年度
營業收入淨額	75,548	72,870	76,644	283,302	256,591
營業毛利	13,283	12,987	16,411	50,149	53,589
營業淨利（淨損）*	6,843	6,382	9,847	24,926	29,646
稅前淨利（淨損）*	6,150	7,810	9,579	24,866	28,548
所得稅利益（費用）*	(1,266)	(1,127)	(1,475)	(4,845)	(4,266)
非控制權益	(322)	(315)	(240)	(970)	(645)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）*	4,562	6,368	7,864	19,051	23,637
基本每股盈餘(新台幣元)*	0.60	0.83	1.02	2.49	3.07
稀釋每股盈餘(新台幣元)*	0.58	0.69	0.99	2.39	2.96

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	104 年度 第四季	104 年度 第三季	103 年度 第四季	104 年度 全年度	103 年度 全年度
營業收入淨額	38,406	39,862	43,884	154,544	159,712
營業毛利	9,992	10,651	13,772	40,142	44,706
營業淨利（淨損）*	5,355	5,644	8,931	21,646	26,500
稅前淨利（淨損）*	5,718	7,433	9,273	23,610	27,501
所得稅利益（費用）*	(1,105)	(1,016)	(1,344)	(4,367)	(3,675)
非控制權益	(51)	(49)	(65)	(192)	(189)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）*	4,562	6,368	7,864	19,051	23,637

* 標記之數字已反應矽品公司公告之 2015 年第四季及全年自結獲利報告。

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	55
電腦	12
汽車, 消費性電子及其它	33
前十大客戶佔營收比重	54

銷售地區別佔比	%
北美	61
歐洲	10
台灣	17
日本	5
亞洲其它地區	7

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	33
IC Wirebonding	58
Discrete and Others	9
封裝資本支出金額	64 百萬美元
打線機台數	15,568 台

測試業務產品組合	%
後段測試	77
晶圓測試	19
前段測試	4
測試資本支出金額	18 百萬美元
測試機台數	3,435 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	64
電腦	15
消費性電子	11
工業用	5
汽車電子	4
其它	1
前十大客戶佔營收比重	92
EMS 資本支出金額	5 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2016 年第一季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之產能持平而產能利用率將較上季下滑高個位數百分比；
- 半導體封測事業之毛利率應與 1Q14 水準相近；
- 電子代工服務生意量將會略低於去年同期水準；
- 電子代工服務毛利率應較上季小幅下滑。